

◆ 真空封止装置 ◆



－構成－

プロセスチャンバー・ヒーター部・加重機構部・真空排気系・ガス導入部・電気制御部より構成。カラー液晶タッチパネルにより条件設定・自動手動操作できる他、プロセスチャートや装置稼働状態のリアルタイムモニターが可能。

－装置概要－

本装置は半導体・電子部品など、チップレベルでアッセンブルしていく必要のあるデバイスの、各種接合・封着をおこなうことができます。共晶接合・ろう接・熱圧着接合・各種拡散接合等のボンディングプロセスの開発から量産に対応いたします。

－特徴－

- ▶ 4～6吋角サイズ(100～150mm)エリア範囲の各種封止が可能。
- ▶ ワークを均一に加熱・加圧できるため、良好な封着が得られます。
- ▶ 理想的な加熱・冷却コントロールシステムを開発しました。
- ▶ 真空から加圧雰囲気まで、任意の圧力制御が可能です。

－応用－

- 水晶振動子
- サージアブソーバー等各種電子部品の封止・封着